

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年6月21日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	东吴证券、禧弘资产、笠置资产、汇正资产、南京证券、嘉合基金、太平洋保险、民生证券、长信基金、万家基金、摩根基金、西部利的基金、长江养老、华富基金、兴业基金、工银安盛
活动时间	2024年6月20日
活动地点	策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、网通市场目前公司看到是什么情况？答：公司产品在网络通讯领域应用广泛，主要包括电信级设备、家用 ONT、WiFi 及随身 MiFi、5G CPE 等。未来随着 5G 基站的逐步建设以及各类 5G 应用对于性能和容量的提升导致的更新换代的需求，我们的中高容量的 SLC NAND 应用场景会越来越多，未来在网通领域仍有较大的市场拓展空间。2、去年 MCP 业务发展比较平稳，受行情影响较小，能否详细介绍一下原因？答：MCP 是通过将闪存芯片与 DRAM 进行合封的产品，以同步实现存储与数据处理功能，节约空间的同时提高存储密度。公司的 MCP 系列产品具有 NAND Flash 和 DDR 的多种容量组合，Flash 和 DDR 均为低电压的设计，核心电压 1.8V 可满足目前移动互联网和物联网对低功耗的需求。目前主要针对模块类客户，需求相对比较稳定，应用于工业、车载等领域。从产品的成长性来看，5G 模块是增量市场，未来的市场需求将成倍增长；另外随</p>

	<p>着车联网模块性能需求的不断提高，对 MCP 的容量规格也逐步提升。公司目前可以提供 8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 配置的 MCP 产品。公司将发挥自身的技术优势，持续研发，为客户提供更多样化的产品选择，并继续开拓产品的应用领域。</p> <p>3、公司对大容量的 MLC、TLC 等产品是否有布局？答：公司目前专注于 SLC NAND 的设计研发，同时在 MLC、TLC 与 3DNAND 等领域拥有相应的技术储备。</p> <p>4、公司在 DRAM 产品上有哪些布局？答：公司的 DRAM 产品主要分成两大类，一类是标准 DDR3，另外一部分是低功耗 LPDDR1、LPDDR2，以及 LPDDR4X。公司在 DRAM 产品方面会不断扩充产品品类，不断丰富 DRAM 自研产品组合，提高产品市场竞争力。</p> <p>5、对于车规市场公司是怎样的布局思路？答：车规级产品方面，目前公司的 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 测试，公司的 MCP 产品已向海外的 Tier1 客户出货，主要应用于车联网模块。公司将继续在严苛的车规级应用环境标准下开发新的高可靠性产品，扩大车规级产品线丰富度并在客户端积极进行产品的测试及导入工作。</p>
日期	2024 年 6 月 21 日